

# 皮秒超快激光切割机 简要说明



标准型号：SLCU-11075I

## 皮秒超快激光切割机

型号：SLCU-11075I

### 行业应用

主要应用于 PCB 电路板分板钻孔，LCP 和软硬结合板切割，以及指纹识别摄像头模组切割等。

### 机器优点

- 1、采用皮秒或者飞秒激光器，超短脉冲加工几乎无热传导，适于任意有机&无机材料的高速切割，最小  $3\ \mu\text{m}$  的崩边和热影响区。
- 2、CCD 视觉预扫描&自动抓靶定位，最大加工范围  $650\text{mm}\times 450\text{mm}$ ，XY 平台精度  $\leq \pm 3\ \mu\text{m}$ 。
- 3、支持多种视觉定位特征，如十字、实心圆、空心圆、L 型直角边、影像特征点等。
- 4、实现自动裂片清洗，视觉检测分拣，机器人自动上下料。
- 5、12 年激光微细加工系统研发技术积淀、世界一线品牌关键零组件选型，连续  $7\times 24$  小时无故障工作，产能更高。

序号	项目	技术参数
光学单元		
1	激光器类型	355、532、1064nm 可选 10PS
2	冷却方式	恒温水冷
3	激光功率	10-100W
4	光束质量	$M^2 < 1.3$
5	聚焦方式&加工头数	单点&平场聚焦镜、双头
6	最小聚焦光斑直径	$\Phi 3-15\ \mu\text{m}$
激光加工性能		
7	加工速度	$\leq 120\text{mm/s}$
8	最小崩边	$3\ \mu\text{m}$
9	最大加工材料厚度	2mm
10	最大加工尺寸&精度	12 inches, $\pm 5\ \mu\text{m}$

### 规格参数